



部品内蔵技術委員会主催 2025年度第二回公開研究会

主催：部品内蔵技術委員会

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ「部品内蔵・高密度化を支える先端実装技術 & 材料 & プロセス」

エレクトロニクス実装学会部品内蔵技術委員会(委員長・加藤義尚:福岡大学)では、下記要領で2025年度第二回公開研究会を開催致します。今回は、部品内蔵技術に関する講演と、今後の高密度化を支える先端実装技術 & 材料 & プロセスに関する講演の合計5件の講演となっています。是非、奮ってご参加下さい。

開催日時 2025年9月25日(木) 13:10~17:10

開催方式 現地開催 & WEB (Zoom Webinarシステム利用) ハイブリッド

開催場所: 回路会館地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:10~13:15

オープニング

開会挨拶 部品内蔵技術委員会 幹事

13:15~13:45

講演①「部品内蔵基板と、先端半導体パッケージング設計環境の考察」

株式会社図研 松澤 浩彦 氏【現地講演】

＜概要＞先端半導体では、さらなる集積化・高性能化を可能とする2.5D/3Dパッケージ技術に注目が集まっている。その設計環境の実現には、従来のパッケージ技術に、部品内蔵基板を表現するために培った構造表現が必要になっている。一方で、会社/工程を跨いだコ・デザインを実現できる設計環境も求められる。システムセントリックな設計環境について考察する。

13:50~14:35

講演②「シミュレーションを用いた半導体パッケージ向けの材料設計」

サンユレック株式会社 野口 一輝 氏【現地講演】

＜概要＞本講演では半導体チップ下にアンダーフィルさせる際、マルチチップへ塗布する際の気泡の残存や隣接するチップへの浸透などによる問題が発生する可能性がある。その最適塗布条件を事前に確認するツールとして浸透性シミュレーションを用いそれぞれのリスクを事前に検証した結果を紹介する。また、パッケージの反り・応力に関してもシミュレーションを用いた最適化を用いることが可能で、その結果についても紹介する。

14:40~15:25

講演③「メックの導体表面処理技術の開発ロードマップ紹介と半導体向け弊社技術の紹介」

メック株式会社 吉海 雅史 氏【現地講演】

＜概要＞半導体パッケージ基板における弊社の導体表面処理技術のロードマップを説明させて頂きます。次に、近年弊社が積極的に取り組んでいる半導体後工程向けの技術についても説明させて頂きます。

(休憩10分)

15:35～16:20

講演④ 「アドバンスドパッケージ向け接着・接合技術におけるVUV処理のご紹介」
ウシオ電機株式会社 岡田 和弥 氏【現地講演】

＜概要＞人工知能等の普及に付随し、データセンタや情報処理機器には高速化・大容量化・広帯域化が求められている。半導体の微細化について検討が進む一方で、さらなる性能向上を目指し、半導体パッケージの多層化、高集積化技術に注目が集まっている。本日は次世代半導体パッケージ工程における接着や貼合・接合の課題に対するVUV表面処理技術を用いた弊社の取り組みを紹介する。

16:25～17:10

講演⑤ 「新世代半導体パッケージ基板製造装置とプロセスのご紹介」
信越化学工業株式会社 山崎 瑛一朗 氏【現地講演】

＜概要＞先端半導体パッケージのチップレット間の接続に使われているシリコンインターポーザーは大型化、歩留まり、コストといった課題を抱えています。信越化学は、半導体パッケージ基板や再配線層(RDL)に微細な電気回路パターンを加工するエキシマレーザ装置と新しいプロセスを開発しました。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定 員 回路会館地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
WEB (Zoom Webinar): 200名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:無料、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円、非会員学生:無料、協賛団体(JPCA会員):5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報をご連絡致します。
 - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)
 - ③領収書(宛名会社名選択可)のご発行は、返信メールのマイページから決済後に即日出力が可能です。
 - ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- *キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info¥jiep.or.jp (メールアドレスは¥を@に置き換えてください)